

公司代码：688432

公司简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需经股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所 科创板	有研硅	688432	不适用
----	----------------	-----	--------	-----

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨波	孙媛
联系地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电话	010-82087088	010-82087088
传真	010-62355381	010-62355381
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况



1、主要业务

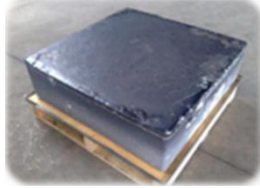


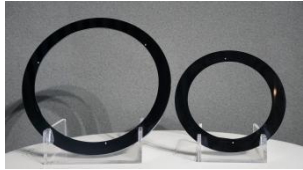
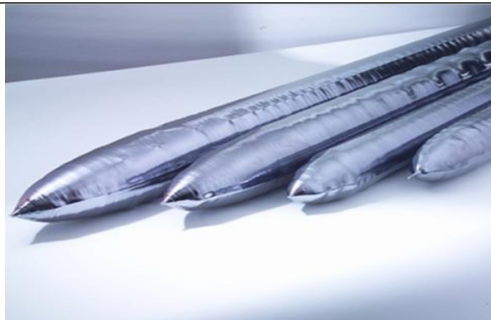
公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、刻蚀设备用零部件、半导体区熔硅单晶及硅片等。产品主要用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、刻蚀设备等，并广泛应用于智能制造、新能源汽车、航空航天等领域。

2、主要产品

公司主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、刻蚀设备用零部件、半导体区熔硅单晶及硅片等。

具体如下：

产品分类	主要尺寸/ 型号	图示
半导体硅抛光片	6-8 英寸	
刻蚀设备用硅材料	11-21 英寸	 单晶硅棒

		 <p>多晶硅锭</p>
刻蚀设备用零部件	8-12 英寸设备用	 <p>单晶曲面电极</p>
		 <p>多晶上接地环</p>
		 <p>硅环</p>
半导体区熔硅单晶	4-8 英寸	

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片、向下游刻蚀设备部件制造企业销售刻蚀设备用硅单晶等产品实现收入和利润。

2、采购模式

为保证公司原辅材料的高质量和稳定性，公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商实行严格认证。根据供应商的资质条件、产品质量、技术实力、供货能力、服务水平、财务状况等情况对供应商进行综合评价，将符合条件的供应商纳入合格供应商范围进行采购。对合格供应商定

期审核评估，并确保主要原辅材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

3、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，紧密围绕客户差异化需求开展产品工艺设计与定制化生产。国内、海外两大市场部基于深入的市场调研与客户需求制定销售计划；生产管理部根据市场部提供的市场需求预测编制年度生产规划，并根据实际客户订单动态调整与细化月度生产计划；技术研发部依据生产计划，制定并审核产品技术规范；制造部则按照生产计划与技术规范，统筹调配生产资源，确保按期完成生产任务。

公司建立了覆盖全流程的质量管控体系，对生产各环节实施严格的测试与检验，确保公司产品品质可靠。凭借在技术研发与生产管理领域的深厚积淀，公司依托 SAP 管理系统、MES 生产管理系统和 WMS 仓储管理系统等信息化平台，实现对产品开发、原材料采购、生产制造与质量检验、出入库、销售服务全业务流程的标准化管控。同时推行精益生产模式，该模式有力保障了产品质量的稳定性和一致性，相关质量指标居于国内行业领先水平。

4、销售模式

报告期内，公司构建以直销为核心，辅以少量经销与代理的多元化销售体系。直销模式下，公司直接对接下游客户并签订购销合同，开展产品销售；经销模式下，公司将产品售予贸易商，由其分销至终端用户；代理模式下，公司直接与终端客户签订销售协议并履行产品交付义务，公司依据合作协议约定向其支付代理佣金。公司产品定价方面，公司以市场化价格为基准，综合考量市场供需格局、客户定制化需求参数、公司产能承载能力及交易结算条款等多重因素，实施灵活的差异化定价策略。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

全球半导体硅片行业正处于一个结构性分化的复苏与转型阶段。整体来看，市场已走出 2023 年的周期性底部，但复苏动力高度集中在以人工智能（AI）驱动的先进制程领域，而成熟制程市场则呈现温和且缓慢的复苏态势。全球半导体硅片市场仍由五大厂商（日本信越、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国世创、韩国 SK siltron）主导，中国大陆正加速追赶，在自主可控战略驱动下，本土企业正加速产能扩张和技术攻关。

(2) 基本特点

一是行业周期性强。半导体硅片行业景气度与全球半导体行业周期紧密绑定，供需失衡时常导致价格剧烈波动。二是资本与技术双密集型。生产设备价格高，所需投资规模巨大，并且随着技术的进步、客户的需求不同，还需要对生产设备不断进行改造和升级，需要大量的运转资金。同时，研发生产过程涉及微电子学、半导体物理学、材料学等诸多学科，需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。三是行业准入壁垒高。客户认证极其严格和漫长，通常需 1-3 年方可完成全面认证，但是一旦通过会形成较为稳定的供应链绑定关系。

(3) 主要技术门槛

半导体硅片制造核心工艺包括单晶生长和硅片精密加工。硅单晶生长核心技术主要包括热场设计、掺杂技术、磁场技术、氧浓度控制等，硅片精密加工技术主要包括硅片厚度变化、硅片翘

曲、硅片弯曲、表面局部平整度、硅片表面粗糙度、硅片几何参数及硅片表面的超洁净控制；蚀刻设备用硅材料及零部件核心指标包括缺陷密度、杂质含量、电阻率范围及分布均匀性等。工艺技术水平决定了产品良品率和参数一致性。上述指标随着集成电路制程的不断进步愈发严格，对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内半导体硅材料龙头企业，是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等研发及创新平台，是集成电路关键材料国家工程研究中心依托单位。公司是中国半导体行业协会常务理事单位、中国电子材料行业协会副理事长单位、中关村集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位、北京半导体行业协会常务理事单位、中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位。

公司坚持创新驱动发展战略，坚持以市场为导向，加快从“硅材料细分领域龙头”向“半导体核心材料与部件综合供应商”演进，不断优化产业布局，持续保持核心优势的稳固，行业影响力不断增强。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新技术方面，呈现“超越摩尔”与“扩展摩尔”并进的发展态势。一方面，硅基材料通过 SOI、应变等技术持续演进；另一方面，硅片作为“平台”，与第三代半导体（SiC/GaN-on-Si）、光电子等异构集成，打开新空间。

新产业方面，形成了“一体两翼”的产业发展格局。以先进逻辑用大硅片为主体，以“特色材料”（SOI、功率等）和“先进封装材料”为两翼，共同驱动增长。

新业态方面，“全球化分工”与“区域化集群”长期共存。既有遵循效率的全球产业链，也有基于安全的区域闭环，中国、美国、欧洲等地的本地化供应链将初步成形。

新模式方面，半导体硅片行业的竞争逻辑已从产能与成本竞争，转向“尖端技术+客户生态+可持续性”的综合竞争。能否进入最先进制程的研发循环，并提供全生命周期解决方案，将成为关键分水岭。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	549,445.93	536,776.84	2.36	504,305.63
归属于上市公司股东 的净资产	452,081.87	434,158.70	4.13	414,799.84
营业收入	100,524.57	99,594.59	0.93	96,040.33
利润总额	28,720.29	31,829.33	-9.77	32,440.99
归属于上市公司股东 的净利润	20,928.06	23,290.38	-10.14	25,418.10

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,952.48	16,302.23	-20.55	16,500.37
经营活动产生的现金流量净额	27,419.07	22,936.80	19.54	26,664.28
加权平均净资产收益率(%)	4.75	5.51	减少0.76个百分点	6.23
基本每股收益(元/股)	0.1682	0.1871	-10.10	0.2037
稀释每股收益(元/股)	0.1682	0.1871	-10.10	0.2037
研发投入占营业收入的比例(%)	9.19	7.86	增加1.33个百分点	8.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	23,082.44	26,009.06	25,565.14	25,867.93
归属于上市公司股东的净利润	4,907.99	5,695.48	5,008.33	5,316.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,426.30	3,930.24	2,561.85	3,034.09
经营活动产生的现金流量净额	6,910.48	7,753.93	5,439.85	7,314.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,647
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股	-

份的股东总数（户）		前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京有研艾斯半 导体科技有限公司	0	384,750,000	30.77	0	无	0	境内非 国有法 人
株式会社 RS Technologies	0	327,090,400	26.16	0	无	0	境外法 人
中国有研科技集团 有限公司	0	230,422,500	18.43	0	无	0	国有法 人
福建仓元投资有限 公司	0	28,215,000	2.26	0	无	0	境内非 国有法 人
香港中央结算有限 公司	15,418,353	17,430,476	1.39	0	无	0	其他
德州芯利咨询管理 中心（有限合伙）	0	14,319,986	1.15	0	无	0	其他
德州芯睿咨询管理 中心（有限合伙）	0	8,559,953	0.68	0	无	0	其他
中信证券股份有限 公司—嘉实上证科 创板芯片交易型开 放式指数证券投资 基金	424,606	8,488,857	0.68	0	无	0	其他
国新风险投资管理 （深圳）有限公司— 深圳诺河投资合伙 企业（有限合伙）	-8,851,434	5,427,255	0.43	0	无	0	其他
广发证券股份有限 公司—国泰中证半 导体材料设备主题 交易型开放式指数 证券投资基金	3,121,135	4,307,290	0.34	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS Technologies 实际控制人为方永义。 2、株式会社 RS Technologies 与福建仓元投资有限公司已签署一致行动协议。				

	3、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

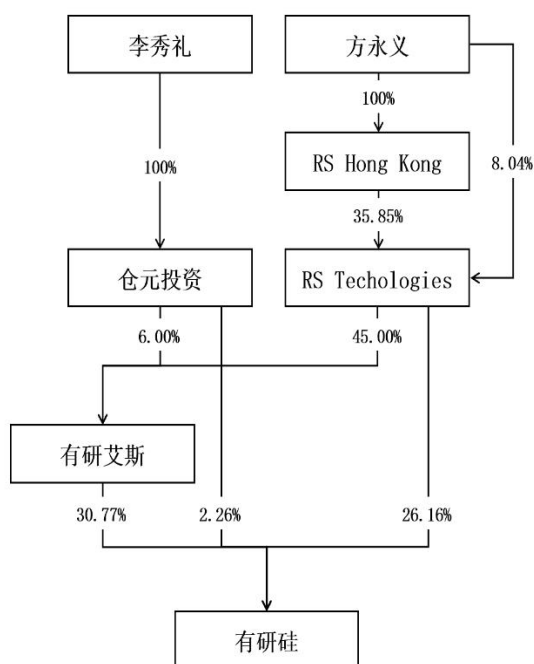
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

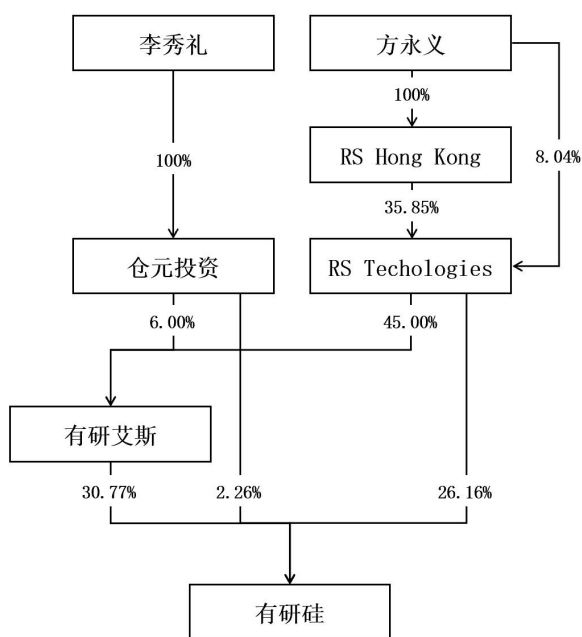
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年度，公司实现营业总收入 100,524.57 万元，同比上升 0.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,928.06 万元，同比下降 10.14%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 12,952.48 万元，同比下降 20.55%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用